

6376611-1 ✓ AKTIV

AMPMODU | [Micro Stack](#)

Interne TE-Nummer 6376611-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, .6 mm [.023 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal, Micro Stack

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **80**

Raster: **.6 mm [.023 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	80
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	10 VAC
-----------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.3 µm[31.5 µin]
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Blattvergoldet

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.3 µm
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.2 mm[.008 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	1 mm[.04 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Lötstift
Art der Leiterplattenmontage	Lötstift
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Angefaste Kanten
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Steckeingangsposition	Oben
Raster	.6 mm[.023 in]
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	6.75 mm[.265 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	45
Verpackungs-Typ	Einsatz

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **Micro Stack**

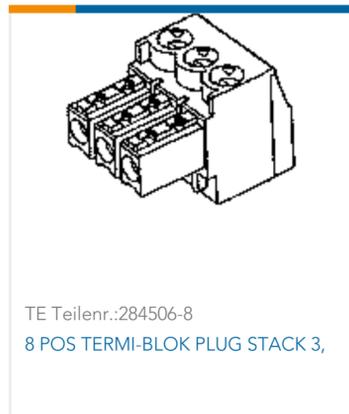


Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(13)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1734510-1
MINI USB, TYPE B, R/A, T/H



TE Teilnr.:284506-8
8 POS TERMI-BLOK PLUG STACK 3,



TE Teilnr.:6376608-1
MICRO STACK REC ASSY 80P



TE Teilnr.:172242-1
Signalstiftwanne



TE Teilnr.:172243-1
DLI 12POS CAP ASSY H TIN

Dokumente

Produktzeichnungen

[MICRO STACK HDR ASSY 80P H=6.75](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6376611-1_G.2d_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6376611-1_G.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6376611-1_G.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Japanisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch